JD-727

无溶剂型硅质绝缘树脂

UL FILE No.E526815

特　　点

- 100%固成分、无溶剂、低黏度。
- 有添加荧光剂，便于 UV 灯下检验。
- 湿气硬化机制，与空气中湿气作用以形成弹性保护层，可采室温硬化或加温硬化。
- 硬化后为柔软弹性体，具优良的绝缘、防潮及耐缓冲的特性。
- 适用于多数基材并达良好的附着性，可广泛用于电路板或电子零件作为保护绝缘用途。
- 符合 UL94 V-0，符合 RoHS 规范。

基 本 物 性

外　　观：		半透明液体
黏　　度：		500 ~ 600 cps
比　　重：		0.95 ~ 1.05
表 干 时 间：	@25°C	10 ~ 15分钟(依涂层厚度而有差异)
硬 化 时 间：		25°C x 24小时 *若欲加温硬化，建议： 以@60°C以下温度并同时增加湿度(RH 55~75%)
硬　　度：	Shore A	30 ~ 36
耐 温 范 围：		-40°C ~ +200°C
玻璃转化温度(Tg)：		<40°C
绝 缘 强 度：		20 kV/mm
抗 张 强 度：		0.5 MPa
断 裂 延 伸 率：		60%
体 积 电 阻：		1.5 x 10^{14} ohm. cm
绝 缘 常 数：	1MHz	3.0
介 电 损 耗：	1MHz	4 x 10^{-3}
保 存 期 限：	@25°C	6个月(未开封)

注 意 事 项

- 为获得达到最佳的保护效果，操作前请先将基板或工件做好前处理与清洁工序。
- 与空气湿气接触时，表面会开始反应结皮，然后由表面逐渐往内层硬化。硬化的速度会因为涂覆的厚度、空气湿度与温度受到影响。厚度越厚或是相对湿度较低，硬化所需的时间也可能因此需要延长，或是请改以加热方式硬化。
- 开罐后，未使用完毕请密封保存，避免接触空气/水气而影响保存期限。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰 研 贸 易 (上 海) 有 限 公 司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976